

**'04年3月期 決算説明会補足説明資料**  
**Year ended March 31, 2004**  
**Analyst Guide**

**株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)**  
**Ferrotec Corporation Code-No.6890 (JASDAQ)**

2004年5月31日  
May 31, 2004

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧		1
2. 連結貸借対照表(資産の部)		2
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)		3
Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)		
4. 連結損益計算書		4
5. 下期計画と実績との差異		5
6. 連結損益計算書(計画)		6
7. 連結キャッシュフロー		7
8. 連結セグメント別売上高		8
9. 主要製品の売上推移		9

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。  
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。  
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.  
We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.  
Unless otherwise stated estimates or forecasts are solely those of our company and subject to change without notice.  
We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.  
This report isn't intended for the use of private investors.

## 1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

### 連結子会社11社、持分法適用会社2社 Consolidated Subsidiaries (11), Company Accounted for by the Equity method(2)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	2,545百万円 2,545million yen	99.9%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	2,079百万円 2,079million yen	100.0%
杭州日磁科技工業園産業開発有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	650百万円 650million yen	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$ 24 thousand	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	その他 Others	511千ユーロ 511thousand euro	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	225百万円 225million yen	100.0%
(株)フェローテッククオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%
アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%
持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン二次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	480百万円 480million yen	49.0%
杭州菱日科技有限公司 HANGZOU LINGRI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	リチウムイオン二次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	350百万円 350million yen	(ダイヤセルテックの 100%子会社)

\*アリオンテック(株)は商法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

## 2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	03/3		04/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 yoy	
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>	<b>10,543</b>	<b>37.3</b>	<b>11,976</b>	<b>41.4</b>	<b>1,433</b>	<b>13.6</b>	
現金及び預金	Cash and Deposits	2,860	10.1	3,123	10.8	263	9.2	1. 主なたな卸資産: 真空シール 308 石英 862 シリコンウェーハ 321 百万円
受取手形・売掛金	Notes and account receivable	3,444	12.2	4,298	14.9	853	24.8	
たな卸資産	Inventories	2,971	10.5	2,791	9.6	179	6.1	
繰延税金資産	Deferred tax assets	108	0.4	113	0.4	5	4.6	
その他	Other assets	1,266	4.5	1,789	6.2	523	41.3	2. その他の増加要因: タイセルテック向け長期貸付金の内、1年内長貸 367百万円の振替による増加
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	108	0.4	140	0.5	32	29.6	
<b>固定資産</b>	<b>Fixed assets</b>	<b>17,736</b>	<b>62.7</b>	<b>16,958</b>	<b>58.6</b>	<b>777</b>	<b>4.4</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>11,195</b>	<b>39.6</b>	<b>10,622</b>	<b>36.7</b>	<b>573</b>	<b>5.1</b>	3. 有形固定資産: 機械装置・運搬具の増加は主にシリコンウェーハ加工設備
建物・構築物	Building and Structures	3,631	12.8	3,234	11.2	396	10.9	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	2,634	9.3	3,445	11.9	811	30.8	4. 建設仮勘定減少要因: 主に3に記載のシリコンウェーハ加工設備の振替
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	1,198	4.2	963	3.3	235	19.6	
土地	land	2,673	9.5	2,602	9.0	71	2.7	
建設仮勘定	Construction in progress	1,057	3.7	375	1.3	681	64.5	
<b>無形固定資産</b>	<b>Intangible fixed assets</b>	<b>2,980</b>	<b>10.5</b>	<b>2,644</b>	<b>9.1</b>	<b>335</b>	<b>11.3</b>	
営業権	Goodwill	1,928	6.8	1,715	5.9	212	11.0	5. 投資有価証券増加要因: 時価の上昇及びアメリゴン株式の取得等
その他	Other assets	1,051	3.7	928	3.2	122	11.7	
<b>投資その他の資産</b>	<b>Investments and other assets</b>	<b>3,560</b>	<b>12.6</b>	<b>3,692</b>	<b>12.8</b>	<b>131</b>	<b>3.7</b>	
投資有価証券	Investment securities	1,273	4.5	1,643	5.7	369	29.1	6. 長期貸付金減少要因: 2に記載のとおり、1年内長期貸付金に振替のため
長期貸付金	Long-term loans	389	1.4	48	0.2	341	87.7	
繰延税金資産	Deferred tax assets	646	2.3	381	1.3	264	41.0	
その他	Other assets	1,271	4.5	1,641	5.7	369	29.1	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	21	0.1	22	0.1	1	4.8	
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>28,279</b>	<b>100.0</b>	<b>28,934</b>	<b>100.0</b>	<b>655</b>	<b>2.3</b>	

参考: 換算レート表

	02/3期		02/9期		03/3期		03/9期		04/3期	
	01/12	02/3	02/6	02/9	02/12	03/3	03/6	03/9	03/12	04/3
US\$	131.95	133.25	119.50	122.60	119.90	120.20	119.80	111.25	107.13	105.69
Singapore \$	71.12	72.36	67.71	68.98	69.16	68.01	68.12	64.37	62.94	62.91
RMB	15.87	16.02	14.51	14.73	14.49	14.51	14.43	13.45	12.94	12.75

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

### 3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	03/3		04/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 yoy	
<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>	<b>8,624</b>	<b>30.5</b>	<b>9,253</b>	<b>32.0</b>	<b>629</b>	<b>7.3</b>	
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,053	3.7	1,889	6.5	835	79.4	1. 短期借入金 + 1年内長期借入金 5,598(同 5,522) *カッコ内は03/3期
短期借入金	Short-term borrowings	3,363	11.9	3,197	11.0	166	4.9	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	2,159	7.6	2,401	8.3	242	11.2	
未払法人税等	Accrued corporation taxes	132	0.5	52	0.2	80	60.6	
その他	Other current liabilities	1,915	6.8	1,712	5.9	203	10.6	
<b>固定負債</b>	<b>Long-term liabilities</b>	<b>5,778</b>	<b>20.4</b>	<b>7,101</b>	<b>24.5</b>	<b>1,322</b>	<b>22.9</b>	
新株予約権付社債	Bonds with warrants	-	-	1,870	6.5	1,870	-	2. スイフ・フロン建転換社債型新株予約権付社債
社債	Bonds	599	2.1	-	-	599	-	
長期借入金	Long-term borrowings	4,933	17.4	5,053	17.5	119	2.4	3. 長期借入金 + 社債等 6,923(同 5,532) *カッコ内は03/3期
その他	Other long-term liabilities	245	0.9	177	0.6	68	27.8	
<b>負債合計</b>	<b>Total Liabilities</b>	<b>14,403</b>	<b>50.9</b>	<b>16,355</b>	<b>56.5</b>	<b>1,952</b>	<b>13.6</b>	4. 有利子負債合計 12,521(同 11,054)
<b>少数株主持分</b>	<b>Minority interests</b>	<b>51</b>	<b>0.2</b>	<b>24</b>	<b>0.1</b>	<b>27</b>	<b>52.9</b>	
<b>資本金</b>	<b>Common stock</b>	<b>5,824</b>	<b>20.6</b>	<b>5,824</b>	<b>20.1</b>	-	-	
<b>資本剰余金</b>	<b>Capital surplus</b>	<b>6,700</b>	<b>23.7</b>	<b>6,700</b>	<b>23.2</b>	-	-	
<b>利益剰余金</b>	<b>Profit surplus</b>	<b>1,075</b>	<b>3.8</b>	<b>293</b>	<b>1.0</b>	<b>782</b>	<b>72.7</b>	
其他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	76	0.3	210	0.7	286	-	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	399	1.4	313	1.1	713	-	
自己株式	Treasury stock-at cost	99	0.3	160	0.6	60	-	
<b>資本合計</b>	<b>Total shareholders' equity</b>	<b>13,824</b>	<b>48.9</b>	<b>12,555</b>	<b>43.4</b>	<b>1,269</b>	<b>9.2</b>	1株当たり株主資本(BPS) 738.06円
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity</b>	<b>28,279</b>	<b>100.0</b>	<b>28,934</b>	<b>100.0</b>	<b>655</b>	<b>2.3</b>	総資産回転率(総資産は期末ベース) 03/3期 0.45回 04/3期 0.51回

### \* 事業セグメントと製品区分 Operations in different industries & Products

装置関連	Production device relation	電子デバイス	Electron device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon products	磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun&Others	基板実装	Surface mount chips		

#### 4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen、%)

科目	Title of account	03/3		04/3		前期比 yoy	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
<b>売上高</b>	<b>Net Sales</b>	<b>12,845</b>	<b>100.0</b>	<b>15,000</b>	<b>100.0</b>	<b>16.8</b>	1. 売上の状況
売上原価	Cost of sales	8,200	63.8	10,218	68.1	24.6	
売上総利益	Gross profit	4,644	36.2	4,781	31.9	3.0	(1) 上期に中国で発生したSARSの影響から、下期の営業活動や生産移管が遅れ、下期以降のCMS事業の売上を圧迫し計画未達となった。
販管費	SG&A expense	4,533	35.3	4,166	27.8	8.1	(2) 国内で行っていたSMT事業を売上不振から撤退し、中国に全量移管した。
<b>営業利益(A)</b>	<b>Operating Income</b>	<b>111</b>	<b>0.9</b>	<b>615</b>	<b>4.1</b>	<b>452.6</b>	(3) ほかの主な事業は、下期に売上高は回復に転じ概ね計画のとおりとなった。
営業外収益	Other income	166	1.3	179	1.2	7.8	2. 売上総利益: 増収効果で増加したものの、売上構成の変化で利益率は低下
受取利息・配当金	Interest&Dividend Income	64	0.5	50	0.3	21.9	
賃貸収入	Lease income	52	0.4	34	0.2	34.6	3. 販管費の減少要因: フィロ・テックが338百万円減少(人件費削減が主)
為替差益	Foreign exchange gain	-	-	-	-	-	
その他	Other income	49	0.4	93	0.6	89.8	
営業外費用	Other expense	904	7.1	972	6.5	7.5	
支払利息	Interest expense	272	2.1	292	1.9	7.4	
たな卸資産処分損	Inventory losses	49	0.4	42	0.3	-	
出資金評価損	Loss on devaluation of investments	73	0.6	68	0.5	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	53	0.4	128	0.9	-	4. ダイヤセルテック
為替差損	Foreign exchange loss	339	2.6	317	2.1	-	5. 主に海外子会社保有の円建債務の為替差損
その他	Other expense	115	0.9	122	0.8	6.1	海外子会社保有の円建債務は、前期より1,000百万円減少し、約2,000百万円
<b>経常利益</b>	<b>Recurring income</b>	<b>626</b>	<b>4.9</b>	<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>-</b>	
特別利益	Extraordinary gain	162	1.3	103	0.7	36.4	
特別損失	Extraordinary loss	362	2.8	484	3.2	33.7	6. 特別損益の主な内容
<b>税前利益</b>	<b>Income before income taxes</b>	<b>827</b>	<b>6.4</b>	<b>559</b>	<b>3.7</b>	<b>-</b>	
法人税等	Income tax (current)	118	0.9	24	0.2	79.7	特別利益: 投資有価証券売却益 92百万円
同 調整額	Income tax (deferred)	41	0.3	61	0.4	-	特別損失: 投資有価証券評価損187百万円
少数株主利益	Minority interest	5	0.0	0	0.0	-	国内石英子会社工場閉鎖費用168百万円
<b>当期利益</b>	<b>Net income</b>	<b>899</b>	<b>7.0</b>	<b>645</b>	<b>4.3</b>	<b>-</b>	
設備投資	Capital expenditures	2,074		2,136		3.0	主に、中国子会社でのシリコンウェル加工設備
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,101		1,177		6.9	
研究開発費	R&D expenses	351		188		46.4	
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,212		1,792		47.9	
1株利益(円)	EPS(yen)	52.2		37.8		-	
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	70.7		105.3		48.9	
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	8.0		8.0		0.0	
期末従業員数(人)	Number of employees	2,700		2,800		3.7	

## 5. 下期計画と実績との差異 Review in the second half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3下期計画(A)		04/3下期実績(B)			コメント
		Original plan		Achievement			
		金額	上期比	金額	上期比	計画比	
		Mil.Yen	yoy	Mil.Yen	yoy	B/A	
売上高	Net Sales	8,876	30.1	8,176	19.8	7.9	1. 連結売上高 装置関連事業では概ね計画通りとなったが、電子デバイス事業、CMS事業が計画を下回った
売上原価	Cost of sales	6,310	34.9	5,541	18.4	12.2	
売上総利益	Gross profit	2,566	19.6	2,634	22.7	2.7	2. 売上総利益: 売上回復により各製品の原価が改善
販管費	SG&A expenses	2,133	0.2	2,036	4.4	4.5	
営業利益(A)	Operating Income	434	2612.5	598	3637.5	37.8	3. 販管費: 経費削減効果
営業外損益	Other income & expense	396	-	509	-	-	
経常利益	Recurring income	37	-	89	-	-	4. 営業外損益 計画時以後、さらに円高が進行し為替差損が拡大
特別損益	Extraordinary gain & loss	54	-	106	-	-	
税前利益	Income before taxes	17	-	17	-	-	
法人税等	Income tax & others	104	-	128	-	-	
下期利益	Net income	121	-	145	-	-	

### 事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		04/3下期計画(A)		04/3下期実績(B)			コメント
		Original plan		Achievement			
製品	Product Lines	金額	上期比	金額	上期比	計画比	
		Mil.Yen	yoy	Mil.Yen	yoy	B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,430	0.4	1,669	16.2	16.7	1. 装置関連: 年末以降、欧米半導体製造装置メーカー向けに真空シールが回復。FPD向けも引き続き好調持続。ただ、国内半導体メーカーを主要顧客とする石英製品及びシリコン製品が予想したほど伸びずセグメント全体では微増に終わった。ただ、石製製品は前年同期比で22%増加、生産の中国移管により収益性も改善。
石英製品	Quartz	1,570	29.1	1,442	18.6	8.2	
シリコン製品	Silicon products	530	36.2	432	11.1	18.5	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	590	19.9	601	18.5	1.9	
装置関連	Equipment related	4,120	9.1	4,143	9.7	0.6	2. 電子デバイス: コンピュータシールは計画を上回ったものの、顧客の生産調整を受けてサーモモジュールが計画未達。磁性流体・その他では、オーディオスピーカー向け磁性流体は計画通り推移
コンピュータシール	Computer Seals	690	5.8	711	9.0	3.0	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	950	18.0	772	4.1	18.7	
ハードディスク関連	HDD products	0	-	-	-	-	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	360	0.8	317	12.7	11.9	
電子デバイス	Electronic devices	2,000	9.9	1,799	1.2	10.1	3. CMS事業: 売上は上半期に比して大きく増加しているが計画に対しては未達
受託生産	CMS	2,755	124.5	2,231	81.8	19.0	
売上高合計	Total Sales	8,876	30.1	8,176	19.8	7.9	

## 6. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	04/3		05/3e		前期比 yoy	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
<b>売上高</b>	<b>Net Sales</b>	<b>15,000</b>	<b>100.0</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33.3</b>	前提為替レート1ドル=105円 1. 売上高: 半導体・FPD関連向けに真空シールや石英製品が伸長。シリコンCMS、 リチウム二次電池加工等のCMS事業拡大もコンピュータシールが減少。 2. 粗利率: CMSの構成比上昇で粗利率低下 3. 販管費: 人員増及び売上げ増加に伴い増加 4. 営業外損益: 主に支払利息310百万円 5. 特別損失: 特段なし。棚卸資産、機械装置等の除却損に備えるもの
売上原価	Cost of sales	10,218	68.1	13,887	69.4	35.9	
売上総利益	Gross profit	4,781	31.9	6,113	30.6	27.9	
販管費	SG&A expense	4,166	27.8	4,912	24.6	17.9	
<b>営業利益(A)</b>	<b>Operating income</b>	<b>615</b>	<b>4.1</b>	<b>1,200</b>	<b>6.0</b>	<b>95.1</b>	
営業外損益	Other income	793	5.3	351	1.8	-	
<b>経常利益</b>	<b>Recurring income</b>	<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>850</b>	<b>4.3</b>	<b>-</b>	
特別利益	Extraordinary gain	103	0.7	5	0.0	95.1	
特別損失	Extraordinary losses	484	3.2	285	1.4	41.1	
<b>税前利益</b>	<b>Income before income taxes</b>	<b>559</b>	<b>3.7</b>	<b>570</b>	<b>2.9</b>	<b>-</b>	
法人税等	Income tax & others	86	0.6	220	1.1	155.6	
<b>当期利益</b>	<b>Net income</b>	<b>645</b>	<b>4.3</b>	<b>350</b>	<b>1.8</b>	<b>-</b>	
設備投資	Capital expenditures	2,136		1,800		15.7	1. 中国での新工場建設、真空シール、サーモジュール等の製造設備
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,177		1,250		6.2	
研究開発費	R&D expenses	188		250		33.0	
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,792		2,450		36.7	
1株当り利益(円)	EPS(yen)	37.80		20.57		-	
1株当りEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	105.34		144.02		36.7	
1株当り配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00		0.0	
期末従業員数(人)	Number of employees	2,800		3,000		7.1	

### \* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

	04/3			05/3e		
	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (B)/(A)	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (B)/(A)
売上高 Net Sales	7,398	15,000	2.0	8,820	20,000	2.3
営業利益 Operating Income	105	615	5.9	160	1,200	7.5
経常利益 Recurring income	177	177	-	400	850	2.1
当期利益 Net income	18	645	-	170	350	2.1

## 7. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	03/3	04/3	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	827	559	
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,101	1,180	
貸倒引当金の増減額 Changes in Allowance for doubtful recievables	251	37	売上増に対応した売上債権増に伴う貸倒引当金の増加
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	309	56	真空シールの出荷拡大により期末棚卸資産が減少
その他資産の増減額 Changes in Others	248	43	
その他 Others	213	455	この他、有形固定資産売却損益、工場閉鎖費用等が3億円強
<b>. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities</b>	<b>321</b>	<b>1,126</b>	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	2,372	1,632	
営業譲受による支出 Payments for acquisition of goodwill	215	-	
投資有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	180	295	アメリカン株式の取得
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	-	200	
子会社株式等の取得又は追加取得による支出 Payments for purchase of Subsidiary stock	482	68	
その他 Others	245	434	
<b>. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities</b>	<b>3,494</b>	<b>2,229</b>	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	1,846	19	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term dept	3,033	2,815	長期借入れの主な実績 フェローテック:700百万円 杭州大和:419百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term dept	1,784	2,542	Ferrotec(USA):696百万円 上海申和:877百万円
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 Proceeds from bonds with warrants	-	1,844	長期借入金の主な返済実績 フェローテック:1,735百万円 杭州大和:209百万円
その他 Others	268	732	フェローテック精密:178百万円 フェロ-テックシリコン:157百万円 転換社債型新株予約権付社債 発行額 23百万スイスフラン 転換価格900円 利率0.125%
<b>. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities</b>	<b>2,827</b>	<b>1,366</b>	(円ベース調達額 1,870百万円)
<b>. 現金及び現金等価物の期末残高 Cash &amp; Cash Equivalent</b>	<b>2,812</b>	<b>3,123</b>	



## 8. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)

### 事業別 Operations in different industries

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period	04/3計画 Y/E plan	04/3上 1st Half	04/3下 2nd Half	04/3通期 Year Ended	構成比 Share	増減率 yoy	05/3上 1st Half	増減率 yoy	05/3下 2nd Half	増減率 yoy	05/3通期 Year Ended	構成比 Share	増減率 yoy
製品 Product type													
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	2,866	1,436	1,669	3,105	20.7	3.2	1,837	27.9	1,855	11.1	3,692	18.5	18.9
石英製品 Quartz	2,786	1,216	1,442	2,658	17.7	15.9	1,731	42.4	1,759	22.0	3,490	17.5	31.3
シリコン製品 Silicon products	919	389	432	821	5.5	-	532	-	642	-	1,174	5.9	43.0
EB-ガン・その他 EB-Gun&Others	1,327	737	601	1,338	8.9	0.8	660	10.4	785	30.6	1,445	7.2	8.0
<b>装置関連 Production device Related</b>	<b>7,898</b>	<b>3,778</b>	<b>4,144</b>	<b>7,921</b>	<b>52.8</b>	<b>15.6</b>	<b>4,760</b>	<b>26.0</b>	<b>5,041</b>	<b>21.6</b>	<b>9,801</b>	<b>49.0</b>	<b>23.7</b>
コンピュータシール Computer Seals	1,342	652	711	1,363	9.1	14.0	561	14.0	125	82.4	686	3.4	49.7
サーモモジュール Thermo-electric Modules	1,755	805	772	1,577	10.5	42.1	947	17.6	1,025	32.8	1,972	9.9	25.0
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	723	363	317	680	4.5	45.3	340	6.3	349	10.1	689	3.4	1.3
<b>電子デバイス Electric devices</b>	<b>3,820</b>	<b>1,820</b>	<b>1,800</b>	<b>3,619</b>	<b>24.1</b>	<b>15.2</b>	<b>1,848</b>	<b>1.5</b>	<b>1,499</b>	<b>16.7</b>	<b>3,347</b>	<b>16.7</b>	<b>7.5</b>
<b>受託生産 CMS</b>	<b>3,982</b>	<b>1,227</b>	<b>2,231</b>	<b>3,458</b>	<b>23.1</b>	<b>100.8</b>	<b>2,892</b>	<b>135.7</b>	<b>3,960</b>	<b>77.5</b>	<b>6,852</b>	<b>34.3</b>	<b>98.1</b>
<b>売上高合計 Total Sales</b>	<b>15,700</b>	<b>6,824</b>	<b>8,176</b>	<b>15,000</b>	<b>100.0</b>	<b>16.8</b>	<b>9,500</b>	<b>39.2</b>	<b>10,500</b>	<b>28.4</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33.3</b>

装置関連 Equipment related	-	27	347	374	60.8	-	<b>ご参考 営業利益</b>						
電子デバイス Electronic devices	-	206	273	479	77.9	4.4							
受託生産 CMS	-	202	19	221	35.9	-							
全社 All	-	14	3	17	2.8	-							
<b>営業利益合計 Operating Income</b>	<b>450</b>	<b>16</b>	<b>598</b>	<b>615</b>	<b>100.0</b>	<b>452.6</b>							<b>730</b>

9. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated					
	98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	1,095	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,105	3,692	
石英製品 Quartz	-	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,658	3,490	
シリコン製品 Silicon products	-	-	-	-	-	-	-	821	1,174	
EB-ガン・その他 EG-Gun&Others	-	-	-	-	1,503	2,134	1,349	1,338	1,445	
<b>装置関連 Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>1,095</b>	<b>1,380</b>	<b>2,430</b>	<b>3,753</b>	<b>10,273</b>	<b>9,115</b>	<b>6,851</b>	<b>7,921</b>	<b>9,801</b>	
コンピュータシール Computer Seals	2,211	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,363	686	
サーモジュール Thermo-electric Modules	410	305	410	591	1,150	893	1,110	1,577	1,972	
ハードディスク関連 HDD products	481	179	502	828	880	467	332	-	-	
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	461	208	385	966	1,547	1,421	1,243	680	689	
<b>電子デバイス Electric devices</b>	<b>3,563</b>	<b>3,778</b>	<b>3,884</b>	<b>4,970</b>	<b>6,162</b>	<b>4,990</b>	<b>4,270</b>	<b>3,619</b>	<b>3,347</b>	
受託生産 CMS	-	-	-	-	-	670	1,722	3,458	6,852	
<b>売上高合計 Total Sales</b>	<b>4,658</b>	<b>5,158</b>	<b>6,314</b>	<b>8,723</b>	<b>16,435</b>	<b>14,775</b>	<b>12,845</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>	

\* 受託生産(CMS)は03/3期から独立表示しております。

(2) 増減率 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated					
	98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	-	34.7	86.6	63.5	-	22.9	18.4	3.2	18.9	
石英製品 Quartz	-	-	64.8	43.4	-	16.9	24.8	15.9	31.3	
シリコン製品 Silicon products	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	
EB-ガン・その他 EG-Gun&Others	-	-	-	-	-	42.0	36.8	0.8	8.0	
<b>装置関連 Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>-</b>	<b>26.0</b>	<b>76.1</b>	<b>54.4</b>	<b>-</b>	<b>11.3</b>	<b>24.8</b>	<b>15.6</b>	<b>23.7</b>	
コンピュータシール Computer Seals	-	39.6	16.2	0.1	-	14.5	28.2	14.0	49.7	
サーモジュール Thermo-electric Modules	-	25.6	34.4	44.1	-	22.3	24.3	42.1	25.0	
ハードディスク関連 HDD products	-	62.8	180.4	65.0	-	46.9	28.9	-	-	
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	-	54.9	85.1	150.8	-	8.1	12.5	45.3	1.3	
<b>電子デバイス Electric devices</b>	<b>-</b>	<b>6.0</b>	<b>2.8</b>	<b>28.0</b>	<b>-</b>	<b>19.0</b>	<b>14.4</b>	<b>15.2</b>	<b>7.5</b>	
受託生産 CMS	-	-	-	-	-	-	157.0	100.8	98.1	
<b>売上高合計 Total Sales</b>	<b>-</b>	<b>10.7</b>	<b>22.4</b>	<b>38.2</b>	<b>-</b>	<b>10.1</b>	<b>13.1</b>	<b>16.8</b>	<b>33.3</b>	

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period	単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated					
	98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3e	
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	23.5	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	20.7	18.5	
石英製品 Quartz	-	12.9	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7	17.5	
シリコン製品 Silicon products	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.9	
EB-ガン・その他 EG-Gun&Others	-	-	-	-	9.1	14.4	10.5	8.9	7.2	
<b>装置関連 Manufacturing Eqpt Related</b>	<b>-</b>	<b>26.8</b>	<b>38.5</b>	<b>43.0</b>	<b>62.5</b>	<b>61.7</b>	<b>53.3</b>	<b>52.8</b>	<b>49.0</b>	
コンピュータシール Computer Seals	47.5	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	9.1	3.4	
サーモジュール Thermo-electric Modules	8.8	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.5	9.9	
ハードディスク関連 HDD products	10.3	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	-	-	
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	9.9	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.5	3.4	
<b>電子デバイス Electric devices</b>	<b>76.5</b>	<b>73.2</b>	<b>61.5</b>	<b>57.0</b>	<b>37.5</b>	<b>33.8</b>	<b>33.2</b>	<b>24.1</b>	<b>16.7</b>	
受託生産 CMS	-	-	-	-	-	6.8	13.4	23.1	34.3	
<b>売上高合計 Total Sales</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	